

LPQBG34A

产品特性 Product Features :

芯片尺寸 Dimensions : 34mil x 34mil (840±50µm x 840±50µm)

芯片厚度 Chip Thickness : 6 mil(150±20µm)

焊盘尺寸 Pad Size :

P 焊盘 (P PAD) : 11.5mil x 31mil

(290±30µm x 780±50µm)

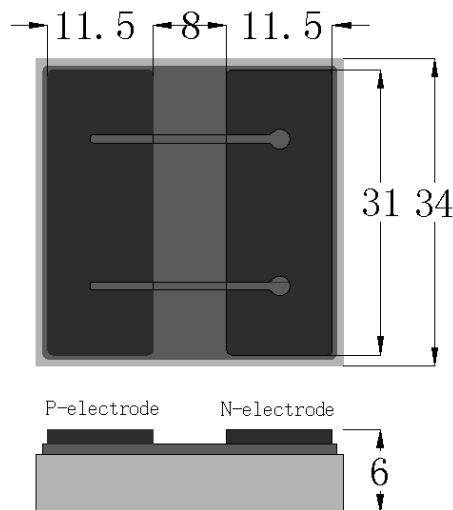
N 焊盘 (N PAD) : 11.5mil x 31mil

(290±30µm x 780±50µm)

焊盘金属 Pad Material :

P 焊盘 (P PAD) : Au

N 焊盘 (N PAD) : Au



光电性能 (Electronic Parameters), TA=25°C						
参数 Parameters	符号 Symbol	条件 Condition	最小值 Min.	典型值 Typ.	最大值 Max.	单位 Unit
开启电压 Turn-On Voltage	Vf1	If=10µA	2.0	---	2.8	V
工作电压 Forward Voltage	Vf2	If=350mA	2.8	3.1	3.4	V
反向漏电流 Reverse Leakage Current	IR	Vr=5V	---	---	2	µA
主波长 Dominate Wavelength	λd	If=350mA	445	---	465	nm
半波宽度 FWHM	Δλ	If=350mA	---	---	30	nm
光功率 Luminous Power	Po	If=350mA	480	---	680	mW